

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-125929

(43)公開日 平成10年(1998)5月15日

(51)Int.Cl.*	識別記号	F I	
H 0 1 L 29/786		H 0 1 L 29/78	6 2 7 Z
21/336		C 2 3 F 4/00	A
C 2 3 F 4/00		H 0 1 L 29/78	6 2 7 D

審査請求 未請求 請求項の数30 O L (全 13 頁)

(21)出願番号	特願平8-300371	(71)出願人	000002369 セイコーエプソン株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
(22)出願日	平成8年(1996)11月12日	(72)発明者	下田 達也 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内
(31)優先権主張番号	特願平8-225643	(72)発明者	井上 聡 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内
(32)優先日	平8(1996)8月27日	(72)発明者	宮沢 和加雄 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内
(33)優先権主張国	日本 (J P)	(74)代理人	弁理士 鈴木 喜三郎 (外2名)

(54)【発明の名称】 剥離方法

(57)【要約】

【課題】被剥離物の特性、条件等にかかわらず、容易に剥離することができ、特に、種々の転写体への転写が可能な剥離方法を提供すること。

【解決手段】本発明の剥離方法(転写方法)は、透光性の基板1上に例えば非晶質シリコンよりなる光吸収層21と金属薄膜よりなる反射層22との積層体である分離層2を形成する工程と、分離層2上に直接または所定の中間層3を介して被転写層4を形成する工程と、被転写層4の基板1と反対側に接着層5を介して転写体6を接合する工程と、基板1の裏面側から分離層2にレーザー光のような照射光7を照射し、光吸収層21にアブレーションを起こさせ、分離層2の層内および/または界面において剥離を生ぜしめ、被転写層4を基板1から離脱させて転写体6へ転写する工程とを有する。

